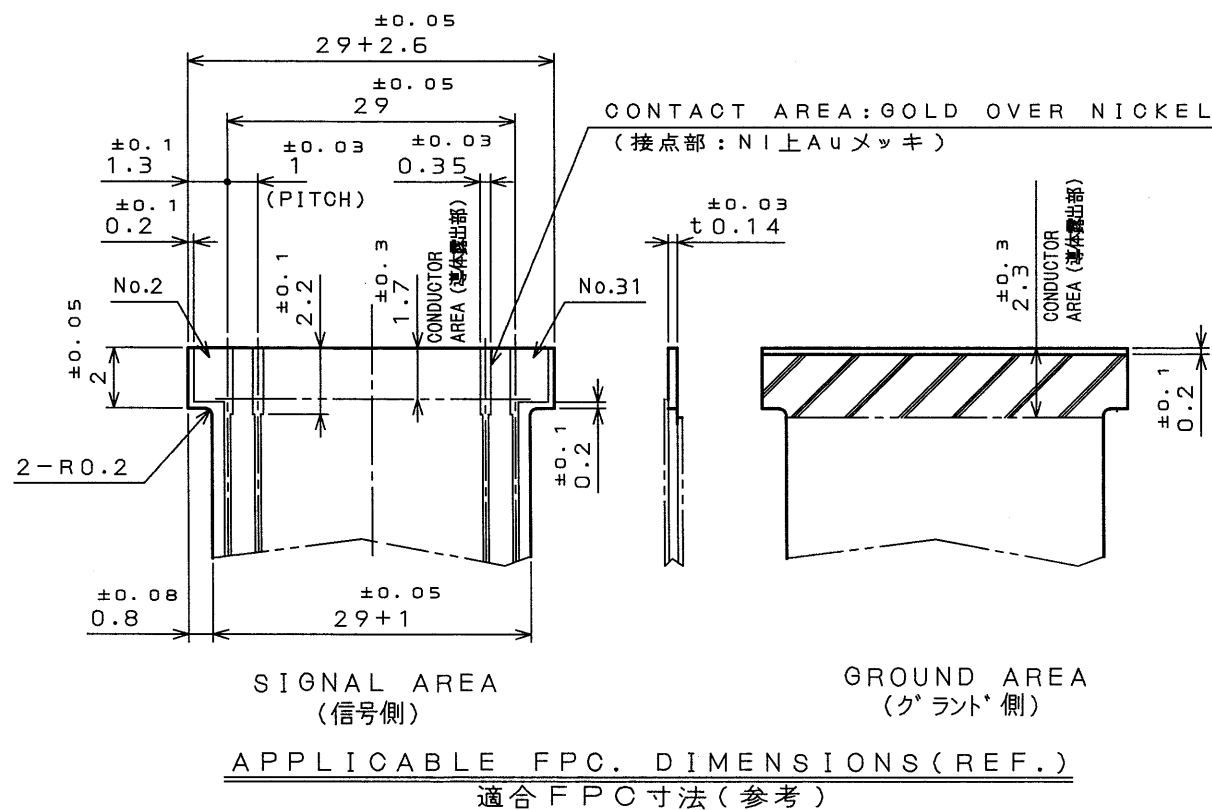
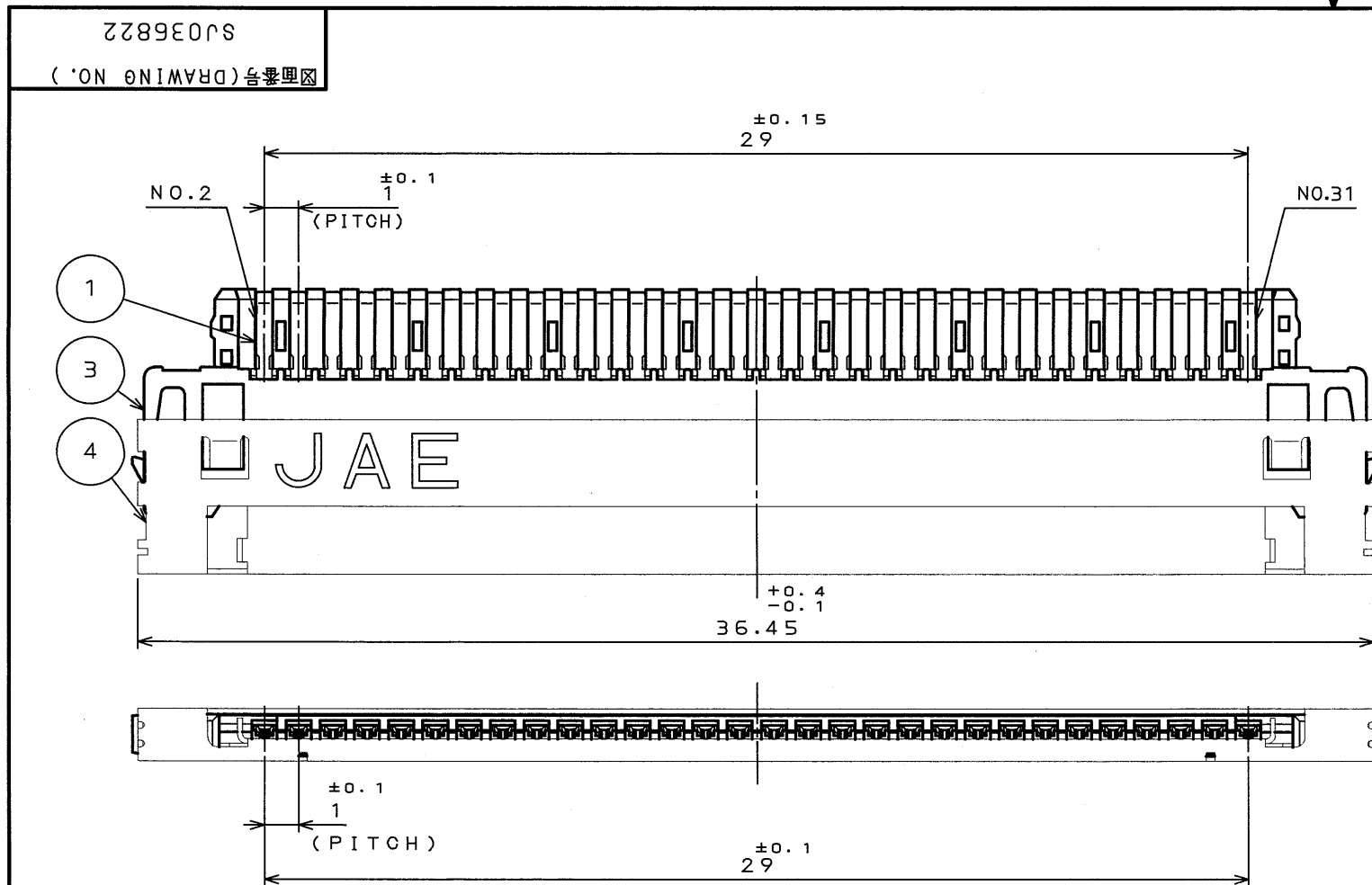
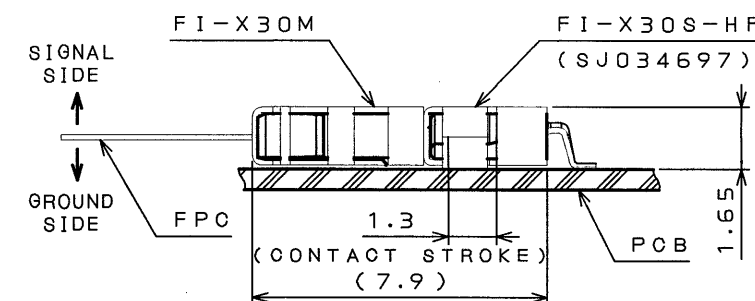
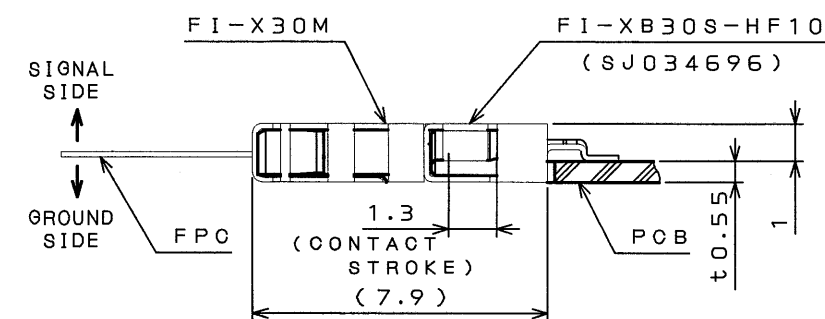
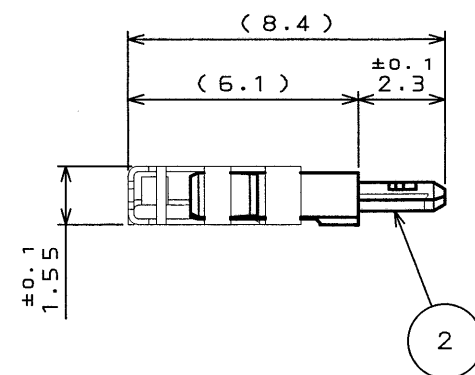
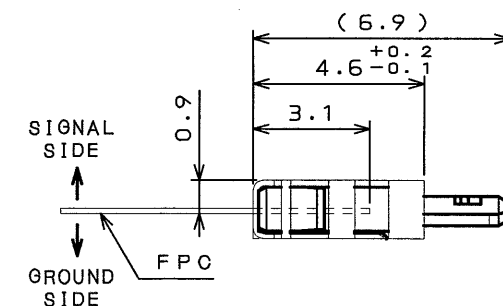


DOF-0-212D(98.02)



版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.



MATED CONDITION (REF.)
嵌合状態図(参考)

4	SHELL	1	COPPER ALLOY	TIN PLATING	
3	INSULATOR	1	GLASS FILLED 4-6Ny		UL94 V-0 BE10E
2	GROUND PLATE	1	COPPER ALLOY	TIN PLATING	
1	CONTACT	30	COPPER ALLOY	GOLD(0.1μmMIN) OVER NICKEL	
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION)		第1版(ORIGINAL DATE) 16.Apr.2002		尺(SCALE) 5:1	社名(COMPANY) 日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
一般公差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	担当 CHK. M.TAKAKU	名称(TITLE) FI-X30MA1 (FPC SIDE)	図面番号(DRAWING NO.) SJ036822
寸法(DIMENSION)		査閲 APPD. A. Kimura	承認 APPD. H. Anemija	重量(WEIGHT)	
. ±0.8					
.X ±0.4					
.XX ±0.1					
.XXX ±					

本図面は日本航空電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO JAE AND CAN NOT BE REPRODUCED WITHOUT WRITTEN CONSENT OF JAE.

CDS-02-180-50160

SIZE A3

版数
(REV.)
1